

## 本期封面



1999年5期

栏目:

DOI:

论文题目: Cu-Nu-Ti合金钎料对Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>陶瓷的润湿与连接

作者姓名: 熊华平 万传庚 周振丰

工作单位: 吉林工业大学材料科学与工程学院, 长春 130025

通信作者: 熊华平

通信作者Email:

文章摘要: 采用座滴法研究了Cu-Ni-(27-56)Ti合金(原子分数, %, 下同)在Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>陶瓷上的润湿行为. 选用真空熔炼合金Cu<sub>38</sub>Ni<sub>30</sub>Ti<sub>32</sub>和Cu<sub>34</sub>Ni<sub>27</sub>Ti<sub>39</sub>作为钎料时, 获得的Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>接头的强度不理想.

关键词: 润湿 钎焊 界面反应 氮化硅陶瓷 连接 钎料

分类号: TG425 TQ174.1

关闭